

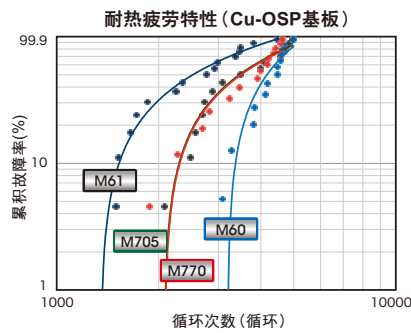
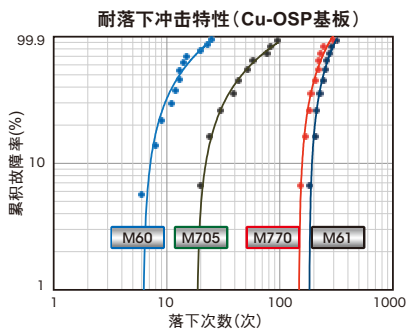
特点

- 采用析出强化控制和界面反应控制技术、解决了要求相反的课题
- 和所有表面处理材料(Cu、Ni、Au)的亲合性都很优异
- 最适合移动设备中的智能手机、车载用焊球实装

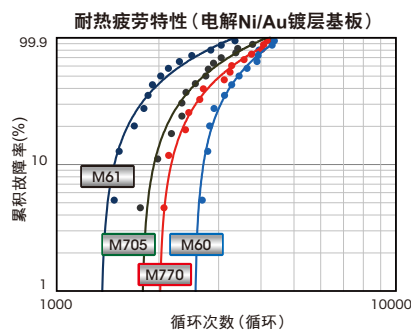
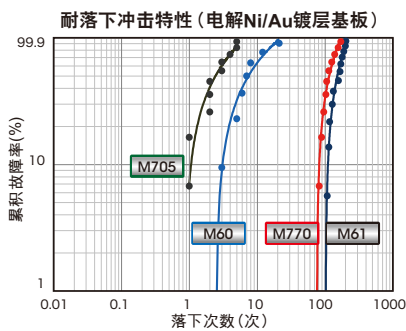


产品规格

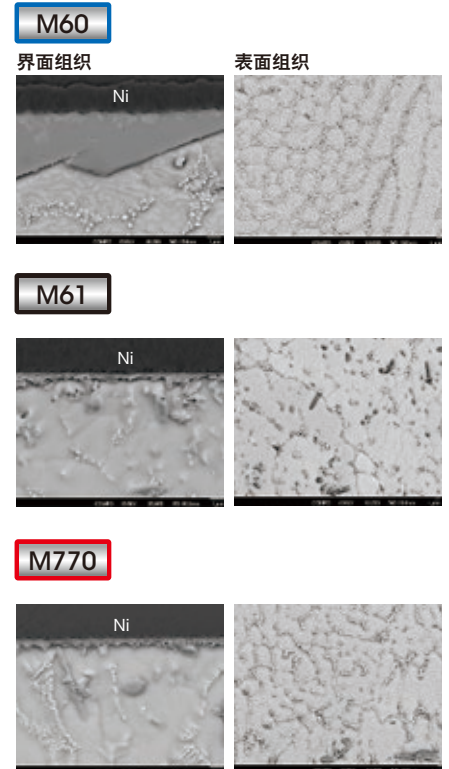
● 使用Cu-OSP基板进行的评价



● 使用电解Ni/Au镀层基板进行的评价



● 各材料の組織



● 根据目的和用途选择材料

	M60	M61	M770
耐落下冲击性	×	◎	◎
耐热疲劳性	◎	×	○

重视耐疲劳特性 : M60
 重视耐落下冲击特性 : M61
 平衡满足两种特性要求 : M770

※以M705为基准的相对评价结果。